

22.11.2004

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年12月24日

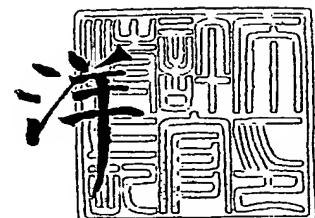
出願番号 Application Number: 特願2003-426354  
[ST. 10/C]: [JP 2003-426354]

出願人 Applicant(s): 昭和電工株式会社

2005年 1月 7日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小川



BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特2004-3120351

**【書類名】** 特許願  
**【整理番号】** P20030259  
**【提出日】** 平成15年12月24日  
**【あて先】** 特許庁長官殿  
**【国際特許分類】** H01G 9/00  
**【発明者】**  
**【住所又は居所】** 栃木県小山市大塚1丁目480番地 昭和电工株式会社小山事業所内  
**【氏名】** 武 幸一郎  
**【特許出願人】**  
**【識別番号】** 000002004  
**【氏名又は名称】** 昭和电工株式会社  
**【代理人】**  
**【識別番号】** 100071168  
**【弁理士】**  
**【氏名又は名称】** 清水 久義  
**【選任した代理人】**  
**【識別番号】** 100099885  
**【弁理士】**  
**【氏名又は名称】** 高田 健市  
**【選任した代理人】**  
**【識別番号】** 100099874  
**【弁理士】**  
**【氏名又は名称】** 黒瀬 靖久  
**【選任した代理人】**  
**【識別番号】** 100109911  
**【弁理士】**  
**【氏名又は名称】** 清水 義仁  
**【選任した代理人】**  
**【識別番号】** 100124877  
**【弁理士】**  
**【氏名又は名称】** 木戸 利也  
**【先の出願に基づく優先権主張】**  
**【出願番号】** 特願2003-369034  
**【出願日】** 平成15年10月29日  
**【手数料の表示】**  
**【予納台帳番号】** 001694  
**【納付金額】** 21,000円  
**【提出物件の目録】**  
**【物件名】** 特許請求の範囲 1  
**【物件名】** 明細書 1  
**【物件名】** 図面 1  
**【物件名】** 要約書 1  
**【包括委任状番号】** 0301906

**【書類名】特許請求の範囲****【請求項1】**

外装ケース内にコンデンサ素子が収納されてなる電解コンデンサにおいて、前記外装ケースと前記コンデンサ素子との間にこれらに接触状態に、熱伝導率が1W/m・K以上の熱伝導材が介装されていることを特徴とする電解コンデンサ。

**【請求項2】**

前記熱伝導率が1W/m・K以上の熱伝導材として、アルミナ粒子、窒化アルミニウム粒子、窒化ホウ素粒子及び酸化亜鉛粒子からなる群より選ばれる1種または2種以上の粒子がマトリックス材中に分散されてなる熱伝導材が用いられた請求項1に記載の電解コンデンサ。

**【請求項3】**

前記熱伝導率が1W/m・K以上の熱伝導材として、マトリックス材中にアルミナ粒子が分散されてなる熱伝導材が用いられた請求項1に記載の電解コンデンサ。

**【請求項4】**

前記粒子の平均粒径が0.5~5μmである請求項2または3に記載の電解コンデンサ。

**【請求項5】**

前記熱伝導材における前記粒子の含有率が70質量%以上である請求項2~4のいずれか1項に記載の電解コンデンサ。

**【請求項6】**

前記マトリックス材としてシリコーンオイル又は/及び変性シリコーンオイルが用いられた請求項2~5のいずれか1項に記載の電解コンデンサ。

**【請求項7】**

前記マトリックス材としてポリオレフィンが用いられた請求項2~5のいずれか1項に記載の電解コンデンサ。

**【請求項8】**

前記ポリオレフィンとしてポリプロピレン又は/及びポリエチレンが用いられた請求項7に記載の電解コンデンサ。

**【請求項9】**

前記コンデンサ素子の高さの30%以上が前記熱伝導材と接触状態にある請求項1~8のいずれか1項に記載の電解コンデンサ。

**【請求項10】**

前記外装ケースはアルミニウム製である請求項1~9のいずれか1項に記載の電解コンデンサ。

**【請求項11】**

アルミニウム電解コンデンサであることを特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載の電解コンデンサ。

**【請求項12】**

前記コンデンサ素子は、陽極箔と陰極箔との間にセパレータが介在されて捲回されたものからなる請求項1~11のいずれか1項に記載の電解コンデンサ。

【書類名】明細書

【発明の名称】電解コンデンサ

【技術分野】

【0001】

この発明は、放熱性に優れた電解コンデンサに関する。

【0002】

なお、この明細書において、「アルミニウム」の語は、アルミニウム及びその合金を含む意味で用いる。

【背景技術】

【0003】

電解コンデンサとしては、有底円筒状の外装ケース内にコンデンサ素子が収容されると共に、該コンデンサ素子に電極端子が設けられた構成のものが多く用いられている。この電解コンデンサは、これにリップル電流を長時間印加したり大電流を印加したりすると、その内部に収容されたコンデンサ素子が発熱する。また、電解コンデンサのサイズが大型になるとコンデンサ素子の発熱量もさらに増大する。このようにコンデンサ素子が発熱してその温度が過度に上昇すると、誘電正接の増大や静電容量の減少が生じるなどコンデンサの電気的諸特性が劣化したり、更にはコンデンサの耐用寿命が短くなるという問題が発生する。

【0004】

そこで、このような問題を解決するため、従来より、コンデンサ素子の温度上昇を抑制することのできる電解コンデンサが提案されている。

【0005】

例えば、コンデンサ素子の端面に金属製集電端子が接合された電解コンデンサが提案されている（特許文献1参照）。また、コンデンサ素子の巻芯部にヒートパイプの吸熱部が接続されるとともに、外に導出されたヒートパイプの放熱部に放熱フィンやヒートシンクが接続された構成の電解コンデンサも提案されている（特許文献2～3参照）。

【0006】

また、有底円筒状の外装ケース内にコンデンサ素子が収容された電解コンデンサにおいて、外装ケースとコンデンサ素子の間の空隙にシリコーンオイルを充填した構成を採用することによって、電解コンデンサの放熱特性を向上できることが記載されている（特許文献4参照）。

【特許文献1】特開2000-77268号公報（請求項1）

【特許文献2】特開平11-329899号公報（請求項1、図1）

【特許文献3】特開平11-176697号公報（請求項1及び2、図1）

【特許文献4】特開2002-110479号公報（請求項1）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

しかしながら、上記特許文献1～3に記載された電解コンデンサでは、コンデンサ素子自体や内部構造自体を設計変更した電解コンデンサを製作する必要があるため、製作コストが高く付いてしまうという難点があった。

【0008】

一方、上記特許文献4に記載された電解コンデンサでは、コンデンサ素子自体や内部構造自体を設計変更する必要はなく、この点で好都合であるものの、その放熱性能は十分に満足できるものではなかった。特に近年、電気自動車、燃料電池車、太陽光発電システム、産業用電源等において、そのインバータ回路やACサーボモータ駆動回路に適用される電解コンデンサとしては、大電流印加時や高リップル電流印加時に発生する熱を効率良く外部に放出することができる放熱特性に優れた電解コンデンサが求められているが、前記特許文献4に記載の技術は必ずしもこのような要求に応えられるものではなかった。

【0009】

この発明は、かかる技術的背景に鑑みてなされたものであって、安価に製作され得ると共に、放熱性に優れた電解コンデンサ、特に大電流や高リップル電流を印加しても発生する熱を効率良く外部に放出することができる放熱特性に優れた電解コンデンサを提供することを目的とする。

#### 【課題を解決するための手段】

##### 【0010】

前記目的を達成するために、本発明は以下の手段を提供する。

##### 【0011】

[1] 外装ケース内にコンデンサ素子が収納されてなる電解コンデンサにおいて、前記外装ケースと前記コンデンサ素子との間にこれらに接触状態に、熱伝導率が1 W/m·K以上の熱伝導材が介装されていることを特徴とする電解コンデンサ。

##### 【0012】

[2] 前記熱伝導率が1 W/m·K以上の熱伝導材として、アルミナ粒子、窒化アルミニウム粒子、窒化ホウ素粒子及び酸化亜鉛粒子からなる群より選ばれる1種または2種以上の粒子がマトリックス材中に分散されてなる熱伝導材が用いられた前項1に記載の電解コンデンサ。

##### 【0013】

[3] 前記熱伝導率が1 W/m·K以上の熱伝導材として、マトリックス材中にアルミナ粒子が分散されてなる熱伝導材が用いられた前項1に記載の電解コンデンサ。

##### 【0014】

[4] 前記粒子の平均粒径が0.5~5 μmである前項2または3に記載の電解コンデンサ。

##### 【0015】

[5] 前記熱伝導材における前記粒子の含有率が70質量%以上である前項2~4のいずれか1項に記載の電解コンデンサ。

##### 【0016】

[6] 前記マトリックス材としてシリコーンオイル又は/及び変性シリコーンオイルが用いられた前項2~5のいずれか1項に記載の電解コンデンサ。

##### 【0017】

[7] 前記マトリックス材としてポリオレフィンが用いられた前項2~5のいずれか1項に記載の電解コンデンサ。

##### 【0018】

[8] 前記ポリオレフィンとしてポリプロピレン又は/及びポリエチレンが用いられた前項7に記載の電解コンデンサ。

##### 【0019】

[9] 前記コンデンサ素子の高さの30%以上が前記熱伝導材と接触状態にある前項1~8のいずれか1項に記載の電解コンデンサ。

##### 【0020】

[10] 前記外装ケースはアルミニウム製である前項1~9のいずれか1項に記載の電解コンデンサ。

##### 【0021】

[11] アルミニウム電解コンデンサであることを特徴とする前項1~10のいずれか1項に記載の電解コンデンサ。

##### 【0022】

[12] 前記コンデンサ素子は、陽極箔と陰極箔との間にセパレータが介在されて捲回されたものからなる前項1~11のいずれか1項に記載の電解コンデンサ。

#### 【発明の効果】

##### 【0023】

[1] の発明では、外装ケースとコンデンサ素子との間にこれらに接触状態に熱伝導率が1 W/m·K以上の熱伝導材が介装されているので、コンデンサ素子で発生した熱はこ

の熱伝導材を介して効率良く外装ケースに伝熱されて外に放熱され、コンデンサ素子が高温になるのを防止でき、これにより耐用寿命の長い電解コンデンサが提供される。また、このように放熱性に優れているので、大電流や高リップル電流を印加した場合でもコンデンサ素子の温度上昇を十分に抑制することができる。また、外装ケースとコンデンサ素子との間に上記特定の熱伝導材を介装するだけで放熱性を向上できるものであり、コンデンサ素子自体や内部構造自体を設計変更する必要がないので、安価に製作され得る。

#### 【0024】

[2] の発明では、熱伝導材として、アルミナ粒子、窒化アルミニウム粒子、窒化ホウ素粒子及び酸化亜鉛粒子からなる群より選ばれる1種または2種以上の粒子がマトリックス材中に分散されてなる熱伝導材を用いているので、即ち熱伝導性に優れたこれら特定化合物をマトリックス材中に分散せしめた熱伝導材を用いているので、コンデンサ素子で発生した熱はこの熱伝導材を介してさらに効率良く外装ケースに伝熱されて外に放熱されるものとなり、コンデンサ素子が高温になるのを一層効果的に防止できる。

#### 【0025】

[3] の発明では、熱伝導材として、マトリックス材中にアルミナ粒子が分散されてなる熱伝導材を用いているので、コンデンサ素子で発生した熱はこの熱伝導材を介してさらに一層効率良く外装ケースに伝熱されて外に放熱され、コンデンサ素子が高温になるのをより一層効果的に防止できる。

#### 【0026】

[4] の発明では、粒子の平均粒径が  $0.5 \sim 5 \mu\text{m}$  であるから、電解コンデンサの放熱性をさらに向上させることができる。

#### 【0027】

[5] の発明では、熱伝導材における粒子の含有率が70質量%以上に設定されているので、より低コストで電解コンデンサの放熱性をさらに向上させることができる。

#### 【0028】

[6] の発明では、マトリックス材としてシリコーンオイル（変性タイプも含む）を用いているので、電解コンデンサの放熱性をさらに向上させることができる。

#### 【0029】

[7] の発明では、マトリックス材としてポリオレフィンを用いているので、電解コンデンサの放熱性をさらに向上させることができる。

#### 【0030】

[8] の発明では、上記ポリオレフィンとしてポリプロピレン又は／及びポリエチレンを用いているので、低コストであると共に、ハロゲンを含有しないことから環境にも十分に配慮したものとなる。

#### 【0031】

[9] の発明では、コンデンサ素子の高さの30%以上が熱伝導材と接触状態にあるので、十分に優れた放熱性を確保することができる。

#### 【0032】

[10] の発明では、外装ケースがアルミニウム製であるから、軽量化を図ることができるとし、電解コンデンサの放熱性もさらに向上させることができる。

#### 【0033】

[11] の発明では、優れた放熱特性を有するアルミニウム電解コンデンサが提供される。

#### 【0034】

[12] の発明では、十分な静電容量を備えると共に優れた放熱特性を有する電解コンデンサが提供される。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0035】

この発明の一実施形態に係る電解コンデンサ（1）の断面図を図1に示す。この電解コンデンサ（1）は、アルミニウム電解コンデンサであって、コンデンサ素子（2）と、該

コンデンサ素子（2）を収容した有底円筒状の外装ケース（3）と、該外装ケース（3）の上面開口部を封口した電気絶縁性の封口部材（6）と、該封口部材（6）に対して貫通して配置された一対の電極端子（7）（7）と、該電極端子（7）の下端部とコンデンサ素子（2）とを接続するリード線（8）とを備えている。更に、前記外装ケース（3）と前記コンデンサ素子（2）との間の空隙にこれら（2）（3）に接触状態に熱伝導率が1W/m·K以上の熱伝導材（5）が介装されている。この電解コンデンサ（1）では、コンデンサ素子（2）で発生した熱は前記熱伝導材（5）を介して効率良く外装ケース（3）に伝熱されて外に放熱されるから、コンデンサ素子（2）が高温になるのを防止することができ、耐用寿命の長い電解コンデンサとなる。このように放熱性に優れているので、大電流や高リップル電流を印加した場合でもコンデンサ素子（2）の温度上昇を十分に抑制することができる。

#### 【0036】

前記コンデンサ素子（2）は、陽極箔と陰極箔との間にセパレータが介在されて捲回されたものからなる。また、このコンデンサ素子（2）には電解液が含浸されている。

#### 【0037】

前記外装ケース（3）としては、金属製のものが好ましく用いられ、特に好適なのはアルミニウム製のものである。アルミニウム製のものを用いた場合には、軽量化を図ることができると共に電解コンデンサ（1）の放熱効率も向上させることができる。

#### 【0038】

前記熱伝導率が1W/m·K以上の熱伝導材（5）としては、アルミナ粒子、窒化アルミニウム粒子、窒化ホウ素粒子及び酸化亜鉛粒子からなる群より選ばれる1種または2種以上の粒子がマトリックス材中に分散されてなる熱伝導材を用いるのが好ましく、この場合にはコンデンサ素子（2）で発生した熱はこの熱伝導材（5）を介してさらに効率良く外装ケース（3）に伝熱されて外に放熱されるものとなり、コンデンサ素子（2）が高温になるのを一層効果的に防止することができる。中でも、前記熱伝導材（5）としては、マトリックス材中にアルミナ粒子が分散されてなる熱伝導材を用いるのが特に好ましく、この場合にはコンデンサ素子（2）が高温になるのをより一層効果的に防止することができる。

#### 【0039】

前記粒子の平均粒径は0.5~5μmの範囲であるのが好ましい。0.5μm未満ではマトリックス材中において粒子が凝集しやすくなるので好ましくないし、一方5μmを超えるとマトリックス材中における粒子の分散安定性が低下して粒子がマトリックス材中ににおいて沈殿しやすいものとなり、これによりコンデンサ素子（2）で発生した熱を効率良く外装ケース（3）に伝熱することが困難になるので好ましくない。

#### 【0040】

前記熱伝導材（5）における前記粒子の含有率は70質量%以上に設定するのが好ましい。70質量%未満では優れた放熱性能が得られ難くなるので好ましくない。

#### 【0041】

前記マトリックス材としては、特に限定されるものではないが、例えばシリコーンオイルの他、アルキル変性シリコーンオイル、エポキシ変性シリコーンオイル等の変性シリコーンオイルが好適に用いられる。これらの中でも、変性シリコーンオイルを用いるのが特に好ましく、この場合にはマトリックス材の熱対流による熱伝導の促進が効果的に行われるものとなり、これにより電解コンデンサ（1）の放熱性がさらに向上する。

#### 【0042】

前記マトリックス材としては、上記例示した化合物以外に、例えば脂肪族系樹脂（ポリオレフィン等）、不飽和ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、メタアクリル樹脂、ビニルエスチル樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等の合成樹脂も使用することができる。前記合成樹脂は低分子量体であっても良いし、高分子量体であっても良い。また、前記合成樹脂はオイル状、ゴム状、硬化物のいずれであっても良い。これら合成樹脂の中でもポリオレフィンを用いるのが好ましく、特に好適な樹脂は、ポリプロピレン、ポリエチレンであ

る。

**【0043】**

この発明において、前記熱伝導材（5）は、前記外装ケース（3）とコンデンサ素子（2）との間に介装されるが、この際熱伝導材（5）の充填高さがコンデンサ素子（2）の高さの30%以上になるように構成されるのが好ましい。即ち、前記コンデンサ素子（2）の高さの30%以上が前記熱伝導材（5）と接触状態にあるように構成されるのが好ましい。このような構成を採用すれば十分に優れた放熱性を確保することができる。

**【0044】**

この発明に係る電解コンデンサは、上記実施形態のものに特に限定されるものではなく、種々設計変更することができる。例えば、上記実施形態では、一対の電極端子（7）（7）は電解コンデンサの上部位置に設けられているが、一方の電極端子を電解コンデンサの上部に設け、他方の電極端子を電解コンデンサの下部に設けた構成を採用することもできる。

**【実施例】**

**【0045】**

次に、この発明の具体的実施例について説明する。

**【0046】**

**<実施例1>**

図1に示す構成の電解コンデンサを製作した。製作に際し、外装ケース（3）としては塩化ビニル樹脂製のものを用いた。また、熱伝導材（5）として、アルミナ粒子（平均粒径2.5μm）80質量部がエポキシ変性シリコーンオイル20質量部に分散されてなる熱伝導材を用い、この熱伝導材をコンデンサ素子（2）の高さの80%の位置まで充填（介装）した。

**【0047】**

**<実施例2>**

前記アルミナ粒子として、平均粒径が1.0μmのアルミナ粒子を用いた以外は、実施例1と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0048】**

**<実施例3>**

前記アルミナ粒子として、平均粒径が3.0μmのアルミナ粒子を用いた以外は、実施例1と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0049】**

**<実施例4>**

前記アルミナ粒子として、平均粒径が4.0μmのアルミナ粒子を用いた以外は、実施例1と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0050】**

**<実施例5>**

前記熱伝導材におけるアルミナ粒子の含有率を70質量%に設定した以外は、実施例1と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0051】**

**<実施例6>**

前記熱伝導材におけるアルミナ粒子の含有率を85質量%に設定した以外は、実施例1と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0052】**

**<実施例7>**

前記熱伝導材におけるアルミナ粒子の含有率を90質量%に設定した以外は、実施例1と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0053】**

**<実施例8>**

前記粒子として、平均粒径2.5μmのアルミナ粒子に代えて平均粒径1.5μmの窒

化アルミニウム粒子を用いた以外は、実施例1と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0054】**

**<実施例9>**

前記粒子として、平均粒径2.5μmのアルミナ粒子に代えて平均粒径2.0μmの窒化ホウ素粒子を用いた以外は、実施例1と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0055】**

**<実施例10>**

前記粒子として、平均粒径2.5μmのアルミナ粒子に代えて平均粒径2.0μmの酸化亜鉛粒子を用いた以外は、実施例1と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0056】**

**<実施例11>**

前記変性シリコーンオイルに代えて、シリコーンオイルを用いた以外は、実施例1と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0057】**

**<実施例12>**

前記変性シリコーンオイルに代えて、ポリプロピレンを用いた以外は、実施例1と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0058】**

**<実施例13>**

前記変性シリコーンオイルに代えて、ポリプロピレンを用いた以外は、実施例5と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0059】**

**<実施例14>**

前記変性シリコーンオイルに代えて、ポリプロピレンを用いた以外は、実施例7と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0060】**

**<実施例15>**

前記変性シリコーンオイルに代えて、ポリプロピレンを用いた以外は、実施例8と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0061】**

**<実施例16>**

前記変性シリコーンオイルに代えて、ポリプロピレンを用いた以外は、実施例9と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0062】**

**<実施例17>**

前記変性シリコーンオイルに代えて、ポリプロピレンを用いた以外は、実施例10と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0063】**

**<実施例18>**

前記変性シリコーンオイルに代えて、ポリエチレンを用いた以外は、実施例1と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0064】**

**<比較例1>**

前記熱伝導材として変性シリコーンオイル（アルミナ粒子を含有しないもの）を用いた以外は、実施例1と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0065】**

**<比較例2>**

前記熱伝導材としてポリプロピレン（アルミナ粒子を含有しないもの）を用いた以外は、実施例12と同様にして電解コンデンサを得た。

**【0066】**

上記のようにして得られた電解コンデンサに対して下記評価法により放熱特性を評価した。その結果を表1～3に示す。

【0067】

<放熱特性評価法>

周囲温度35℃の環境下に電解コンデンサを配置した状態でコンデンサ素子にリップル電流5Aを印加することによって発熱を与え、この時のコンデンサ素子の温度（最大上昇温度）を測定した。なお、コンデンサ素子の温度の測定は、熱電対を用いて行った。

【0068】

【表1】

	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7
熱伝導材の組成 ノ 量 部 分 単 位	アルミナ粒子 (平均粒径2. 5 $\mu\text{m}$ ) アルミナ粒子 (平均粒径1. 0 $\mu\text{m}$ ) アルミナ粒子 (平均粒径3. 0 $\mu\text{m}$ ) アルミナ粒子 (平均粒径4. 0 $\mu\text{m}$ ) 窒化アルミニウム粒子 (平均粒径1. 5 $\mu\text{m}$ ) 窒化ホウ素粒子 (平均粒径2. 0 $\mu\text{m}$ ) 酸化亜鉛粒子 (平均粒径2. 0 $\mu\text{m}$ ) 変性シリコーンオイル シリコーンオイル	80 — — — — — — 20 —	— 80 — — — — — 20 —	— — 80 — — — — 20 —	— — — 80 — — — 30 —	70 — — — — — — 30 —	85 — — — — — — 15 —
熱伝導材の熱伝導率 (W/m · K)	2. 0	1. 8	2. 0	1. 7	1. 5	2. 2	2. 5
コンデンサ素子の発熱温度 (最大上昇温度) (°C)	68. 6	68. 8	68. 6	68. 9	69. 1	68. 5	68. 3

【0069】  
【表2】

熱伝導材の組成 ／質量部	単位	実施例8	実施例9	実施例10	実施例11	比較例1
アルミナ粒子（平均粒径2.5μm）		—	—	—	8.0	—
アルミナ粒子（平均粒径1.0μm）		—	—	—	—	—
アルミナ粒子（平均粒径3.0μm）		—	—	—	—	—
アルミナ粒子（平均粒径4.0μm）		—	—	—	—	—
塗化アルミニウム粒子（平均粒径1.5μm）		8.0	—	—	—	—
塗化ホウ素粒子（平均粒径2.0μm）		—	8.0	—	—	—
酸化亜鉛粒子（平均粒径2.0μm）		—	—	8.0	—	—
変性シリコーンオイル		2.0	2.0	2.0	—	100
シリコーンオイル		—	—	—	2.0	—
熱伝導材の熱伝導率(W/m・K)		3.0	2.2	1.0	2.0	0.3
コンデンサ素子の発熱温度(最大上昇温度)(°C)		68.1	68.5	70.0	68.6	73.2

【0070】

【表3】

		実施例12	実施例13	実施例14	実施例15	実施例16	実施例17	実施例18	比較例2
熱伝導材の組成部 単位	アルミナ粒子 (平均粒径 2. 5 $\mu\text{m}$ )	80	70	90	—	—	—	80	—
	アルミナ粒子 (平均粒径 1. 0 $\mu\text{m}$ )	—	—	—	—	—	—	—	—
	アルミナ粒子 (平均粒径 3. 0 $\mu\text{m}$ )	—	—	—	—	—	—	—	—
	アルミナ粒子 (平均粒径 4. 0 $\mu\text{m}$ )	—	—	—	—	—	—	—	—
	塗化アルミニウム粒子 (平均粒径 1. 5 $\mu\text{m}$ )	—	—	80	—	—	—	—	—
	塗化ホウ素粒子 (平均粒径 2. 0 $\mu\text{m}$ )	—	—	—	80	—	—	—	—
	塗化亜鉛粒子 (平均粒径 2. 0 $\mu\text{m}$ )	—	—	—	—	80	—	—	—
	ポリプロピレン	20	30	10	20	20	20	—	100
	ポリエチレン	—	—	—	—	—	—	20	—
熱伝導材の熱伝導率 (W/m・K)		1. 9	1. 4	2. 4	1. 6	2. 1	1. 0	1. 9	0. 15
コゲンガ素子の発熱温度 (最大上昇温度) (°C)		68. 7	69. 2	68. 4	69. 0	68. 6	70. 3	68. 7	74. 5

**【0071】**

表1～3から明らかなように、この発明の実施例1～18の電解コンデンサは、放熱性に優れており、コンデンサ素子の発熱による温度上昇が効果的に抑制されていた。これに対し、比較例1、2の電解コンデンサでは放熱性が不十分であり、コンデンサ素子の発熱による温度上昇が大きかった。

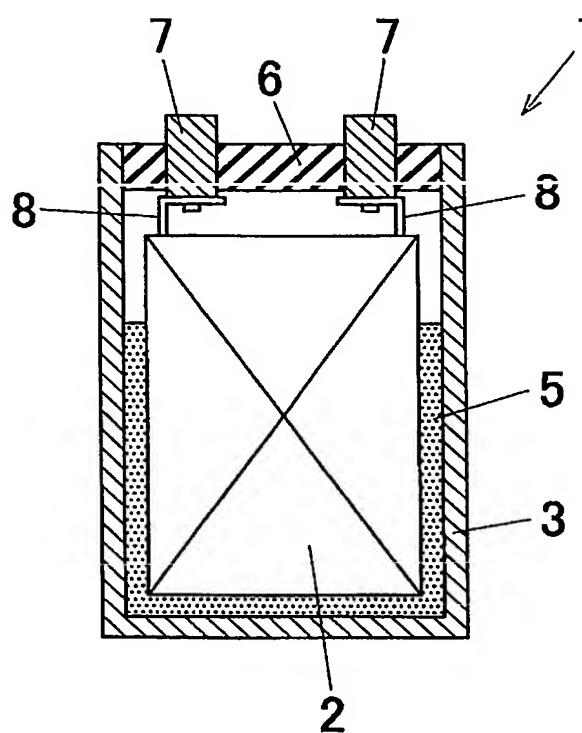
**【図面の簡単な説明】****【0072】**

【図1】この発明に係る電解コンデンサの一実施形態を示す縦断面図である。

**【符号の説明】****【0073】**

- 1 … 電解コンデンサ
- 2 … コンデンサ素子
- 3 … 外装ケース
- 5 … 热伝導材

【書類名】 図面  
【図 1】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 安価に製作され得ると共に、大電流や高リップル電流を印加しても発生する熱を効率良く外部に放出することができる放熱特性に優れた電解コンデンサを提供することを目的とする。

【解決手段】 外装ケース3内にコンデンサ素子2が収納されてなる電解コンデンサ1において、外装ケース3とコンデンサ素子2との間にこれらに接触状態に、熱伝導率が1W/m·K以上の熱伝導材5を介装せしめる。前記熱伝導材5としては、アルミナ粒子、窒化アルミニウム粒子、窒化ホウ素粒子及び酸化亜鉛粒子からなる群より選ばれる1種または2種以上の粒子がマトリックス材中に分散されてなる熱伝導材を用いるのが好ましい。前記マトリックス材としては、シリコーンオイル、変性シリコーンオイル、ポリオレフィン（ポリプロピレン、ポリエチレン等）を用いるのが好ましい。

【選択図】 図1

特願 2003-426354

出願人履歴情報

識別番号

[000002004]

1. 変更年月日

1990年 8月27日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区芝大門1丁目13番9号

氏 名

昭和電工株式会社

# **Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)**

International application number: PCT/JP04/016385

International filing date: 28 October 2004 (28.10.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2003-426354  
Filing date: 24 December 2003 (24.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 20 January 2005 (20.01.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record.**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

**BLACK BORDERS**

**IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

**FADED TEXT OR DRAWING**

**BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

**SKEWED/SLANTED IMAGES**

**COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

**GRAY SCALE DOCUMENTS**

**LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

**REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

**OTHER:** \_\_\_\_\_

## **IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**